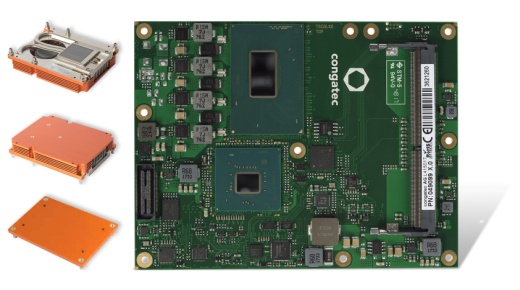
****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **读者查询:** | **媒体联系:** |  |
| **德国康佳特科技** | **德国康佳特科技** |
| Nick Lin 林忠义 | Crysta Lee 李佳纯 |
| 电话: +86-21-60255862 | 电话: +86-21-60255862x8931 |
| [sales-asia@congatec.com](mailto:sales-asia@congatec.com)  www.congatec.cn | crysta.lee@congatec.com  www.congatec.cn |

**

*Text and photograph available at:* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

***欢迎莅临参观上海工博会  
德国观康佳特 (展位号: 6.1H A059)***

Press release

最新康佳特 COM Express 计算机模块  
基于3 GHz 英特尔® 酷睿™ i3 处理器

**最新经济高效入门级平台  
面向高端嵌入式运算**

**Shanghai, China, 19 September 2018 \* \* \*** 提供标准和定制化嵌入式计算机板卡与模块的领先供应商—德国康佳特科技，推出全新跌破价格的计算机模块，该模块基于英特尔最新酷睿™ i3-8100H 处理器平台，是高端嵌入式运算的入门款模块。该高性能平台具备高性价比和优化的四核处理器性能表现，并支持低功耗高带宽DDR4内存，而快速的16 PCle Gen.3 通道使其成为需要多个GPUs来执行大规模并行处理的人工智能(AI)和机器学习应用的理想选择。此外，功能更强大的集成英特尔®高清图形UHD630显卡在时钟速率和驱动程序方面进行优化，能提供额外的TDP余量来支持更多的GPGPU性能表现或4K UHD图形。所有这些功能使这款全新COM Express Basic 计算机模块成为每瓦性能表现最佳的典范，适用于需要复杂被动或主动式散热解决方案的价格敏感高性能应用。

代表性的应用包含支持各种连结的嵌入式 工业级和物联网(IoT)应用到具备嵌入式人工智能的新系统，因为这些应用皆需要比先前推出的第八代英特尔酷睿 i5和i7版本具备更强大能耗比的高端嵌入式性能。

康佳特产品管理总监 Martin Danzer 解释到: “ 3 GHz 四核英特尔酷睿i3 处理器和新型HM370 PCH提供了特别高的每瓦性能表现和大获全胜的性价比且价格现已大幅下降 ，所以客人能以更合理的价格水平对需要大量计算能力的AI应用提供服务。”

**详细功能说明**

新conga-TS370 COM Express Basic Type6 计算机模块搭載四核英特尔® 酷睿™ i3 8100H处理器，可提供45瓦TDP配置至35瓦，支持6MB高速缓存，并提供高达32GB 双通道DDR4 2400内存。与先前的第七代英特尔®酷睿™处理器比较，改进的内存带宽还有助于提升集成英特尔® UHD630图形显卡的图形和GPGPU性能，并在24个执行单位中具有高达 1.0 GHz的最大动态频率。透过DP1.4, HDMI, eDP和LVDS可支持最多3个独立4K 显示(最高达 60 Hz)。设计人员首次可以单纯通过软件从eDP切换到LVDS，无需修改任何硬件。该模块提供杰出的高带宽I/O, 包括4x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s), 8x USB 2.0 和 1x PEG 以及8x PCIe Gen 3.0 通道，可用于强大的系统扩展，包括英特尔® 傲腾™ 储存。可执行所有Linux 操作系统以及64位微软Win10和Win10 IoT 版本。康佳特独特的技术集成支持使功能更加完整。此外，康佳特也提供广泛的配件包含高效的散热解决方案，可协助提高可靠性和MTBF，以及全面的技术服务，来简化新模块集成至客户具体应用。

该模块将在中国国际工业博览会(CIIF) 首次展示 (展位号: 6.1H A059) ，现在已在全球提供以下配置支持：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processor** |  | **Cores/ Threads** |  | **Clock [GHz] (Base/cTDP down)** |  | **Cache (MB)** |  | **GPU Compute Units** |  | **TDP/ cTDP [W]** |
| Intel® Core™ i3-8100H |  | 4 / 4 |  | 3.0 / 2.6 |  | 6 |  | 24 |  | 45 / 35 |

conga-TS370 高性能COM Express Type6计算机模块详情：<https://www.congatec.com/products/com-express-type6/conga-ts370.html>

**关于德国康佳特**

德国康佳特科技,为嵌入式计算机模块COMExpress,Qseven和SMARC的领导供应商，且提供单板计算机及定制设计服务。康佳特产品可广泛使用于工业及应用，例如工业化控制，医疗科技，车载，航天电子及运输…等。公司的核心及关键技术包含了独特并丰富的BIOS功能，全面的驱动程序及板卡的软件支持套件。用户在他们终端产品设计过程，通过康佳特延展的产品生命周期管理及现代质量标准获得支持。自2004年12月成立以来, 康佳特已成为全球认可和值得信赖的嵌入式计算机模块解决方案的专家和合作伙伴。目前康佳特在美国，台湾，日本，澳大利亚，捷克和中国设有分公司。更多信息请上我们官方网站[www.congatec.cn](file:///C:\Users\schmid\AppData\Users\beckylin\AppData\Local\Users\beckylin\AppData\Local\Temp\notes5CC417\www.congatec.cn)关注康佳特官方微信: congatec, 关注康佳特官方微博[＠康佳特科技](https://www.weibo.com/congatec)

\* \* \*

*Intel and Intel Core are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*